



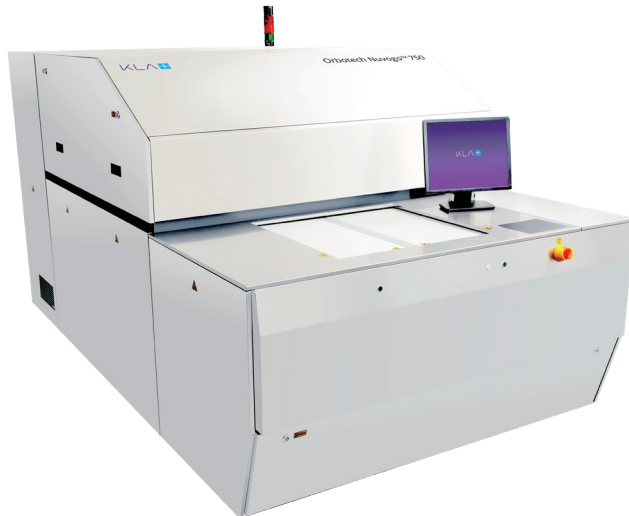
Orbotech Nuvogo™ 750/750XL

量產直接成像 (DI)



Orbotech Nuvogo 750/750XL

Orbotech Nuvogo 750/750XL 是一款量產直接成像 (DI) 解決方案，針對使用 405nm 感光膜的 MLB 和 HDI PCB 製造商進行優化。採用 KLA 經業界驗證的 Large Scan Optics™ (大鏡面掃描) 技術，確保了高成像品質和高產能 (連線產能高達每天 7,000 片板子)，在高速下呈現最佳品質的同時並有助於降低整體擁有成本 (TCO)。



優勢

量產數位成像

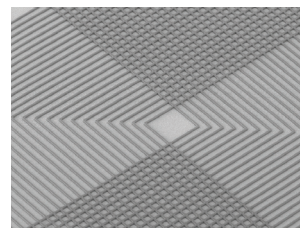
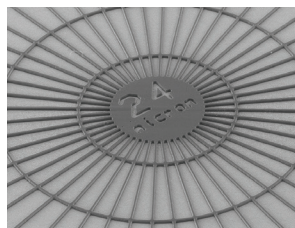
- 高能量雷射實現最高產能
- 採用雙檯面傳輸機製，優化成像時間
- 潔淨全自動的操作環境

採用 LSO™ (大鏡面掃描) 技術實現高成像品質

- 高景深 (DOF)，在多種高低不均的板子上均能實現高成像品質
- 完美匹配 405nm 感光膜
- 優化的漲縮模式，可以實現 $\pm 12\mu\text{m}$ 的出色對位精度

低整體擁有成本 (TCO)

- 硬體與功能的設計專注於多層板和 HDI PCB 製造商的特殊需求，可以大幅降低每片板子曝光成本
- 優化的光源路徑匹配 405nm 波長帶來更低的每面曝光成本
- 整體效益提升大幅節省長期成本



24 μm 的線寬/間距

Technologies



Orbotech 750/750XL 量產數位成像解決方案

Orbotech Nuvogo 750/750XL 採用 KLA 的高能量 405nm 雷射，帶來優化的光源路徑。配備先進的光學和電子系統，旨在以超快速度來實現極細的線路結構。其雙檯面傳輸機製讓系統能夠充分利用時間進行板子成像。系統的快速設置和自動靶點捕捉功能實現了流暢的料號轉換。Orbotech Nuvogo 750/750XL 在潔淨及自動化的環境中運作，避免了人為操作帶來的損害。

採用 LSO™（大鏡面掃描）技術實現高成像品質

Orbotech Nuvogo 750/750XL 配備 KLA 經業界驗證的 LSO™（大鏡面掃描）技術，提供高景深，在高低不均的的板子上也能帶來出色的結果。單次掃描即可對整張板子進行均勻成像。

創新的漲縮模式

- 自動漲縮/固定漲縮/群組漲縮/智慧漲縮

可追溯性

- 通過動態標記進行板子追蹤：序號標記；小排版和 PCB；日期與時間標記；漲縮標記和由字母數位組成的設備號碼，一維條碼或二維條碼 (Data Matrix Code)。

對位精度

- 對位精度 $\pm 12\mu\text{m}$

簡單易用

- 友好的使用者介面，易學易用
- 與 CAM 無縫連接，確保設定快速又簡單
- 識別多種不同靶點類型，適合所有生產需求

低整體擁有成本 (TCO)

Orbotech Nuvogo DI 系列解決方案可以在降低整體擁有成本的同時滿足行業對高階量產不斷增長的需求。更值得強調的是 Orbotech Nuvogo 750/750XL 使用優化光學的 405nm 雷射，能與 405nm 感光膜完美匹配，同時降低機器成本。

規格

	Orbotech Nuvogo 750	Orbotech Nuvogo 750XL
最高產能*	300 面//每小時 成像尺寸 24"x18"	290 面//每小時 成像尺寸 25"x18"
最小特徵尺寸*	24µm	
成像能量範圍	25 - 2,200mj/cm ²	
解析度	2.0µm	
對位精度 FtG**	±12µm	
層間對位精度 FtB**	24µm	
最大基板尺寸	635mm x 660mm	660mm x 812mm
最大曝光尺寸	609.6mm x 660mm	635mm x 812mm
基板厚度	0.025mm - 8mm	

* 取決於解析度和光阻特性

** 所有值均為 3σ，全板面

-以上規格如有變更，恕不另行通知

KLA 支持

保持系統生產力是 KLA 良率優化解決方案不可或缺的一部分。包括系統維護、全球供應鏈管理、降低成本和減少報廢、系統遷移、加強性能和生產率以及轉售認證工具。

KLA Corporation

www.orbotech.com/pcb | www.kla.com

Rev 5.0_5-19-2022

©2022 KLA 公司。所有品牌或產品名稱可能為其各自公司的商標。KLA 保留在不另行通知的情況下更改硬體和/或軟體規格的權利。